

Top >> Products >> マイクロセンシングデバイス >> フォト・マイクロセンサ >> 透過形

Products

≫ プリント基板用リレー

≫ DC高容量リレー (形G9E□シリーズ)

≫ 車載用リレー

≫ ソリッドステート・リレー

≫ スイッチ

≫ コネクタ

≫ 機器組込みセンサ

≫ マイクロセンシングデバイス

≫ 光通信デバイス

≫ 液晶用バックライト

≫ MEMS / IC

≫ New Products

New Technology

≫ Electronics Mail申し込み



PDFをご覧いただくにはAdobe Reader
が必要です。Adobe社のホームページから
ダウンロードしてください。

Micro Sensing Device

マイクロセンシングデバイス



商品特長

フォト・マイクロセンサ [透過形]
形EE-SV3シリーズ

定格
性能

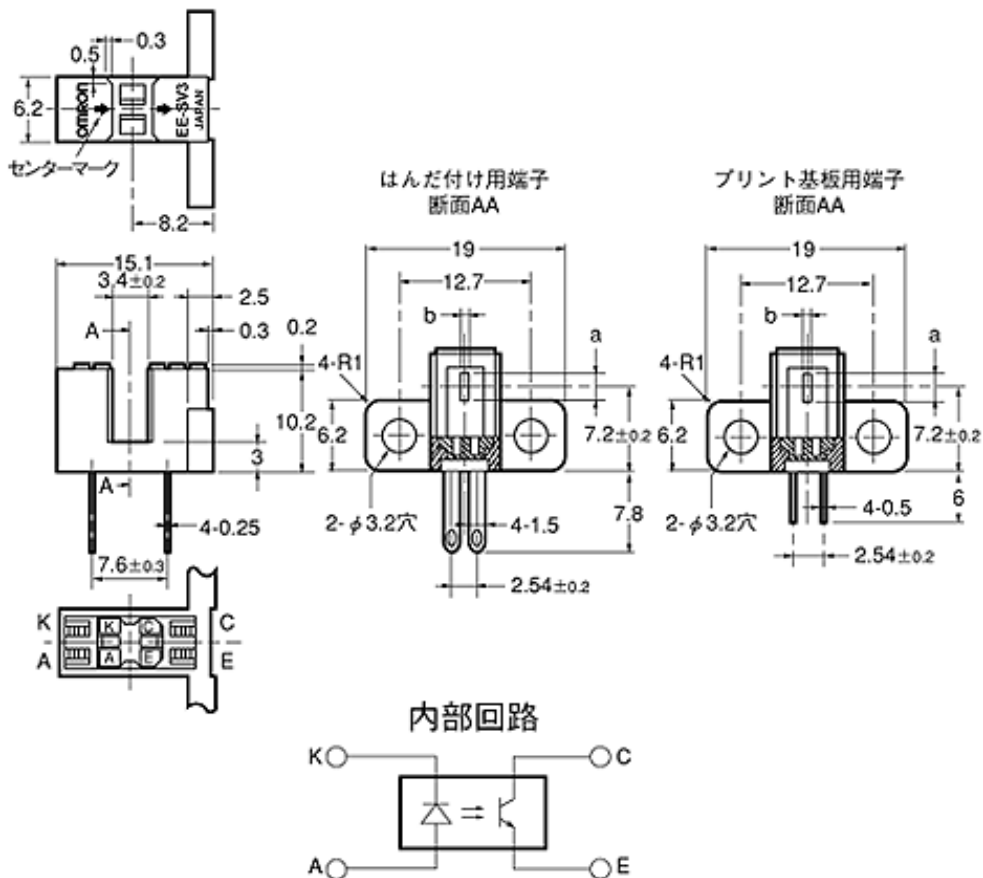
外形
寸法

- スリット幅0.2mm,0.5mmの高分解能タイプから
1mmの高感度タイプと横スリットタイプを用意
- はんだ付け用端子タイプ
EE-SV3/-SV3-CS/-SV3-DS/-SV3-GS
- プリント基板用端子タイプ
EE-SV3-B/-SV3-C/-SV3-D/-SV3-G



外形寸法

(単位:mm)



形式

スリット穴 (a×b)

形EE-SV3

2.1×0.5

形EE-SV3-CS	2.1×1.0
形EE-SV3-DS	2.1×0.2
形EE-SV3-GS	0.5×2.1

形式	スリット穴 (a×b)
形EE-SV3-B	2.1×0.5
形EE-SV3-C	2.1×1.0
形EE-SV3-D	2.1×0.2
形EE-SV3-G	0.5×2.1

端子記号	名称
A	アノード
K	カソード
C	コレクタ
E	エミッタ

指定なき寸法公差は下表とする。

寸法区分	公差
3以下	±0.2
3を越え6以下	±0.24
6を越え10以下	±0.29
10を越え18以下	±0.35
18を越え30以下	±0.42